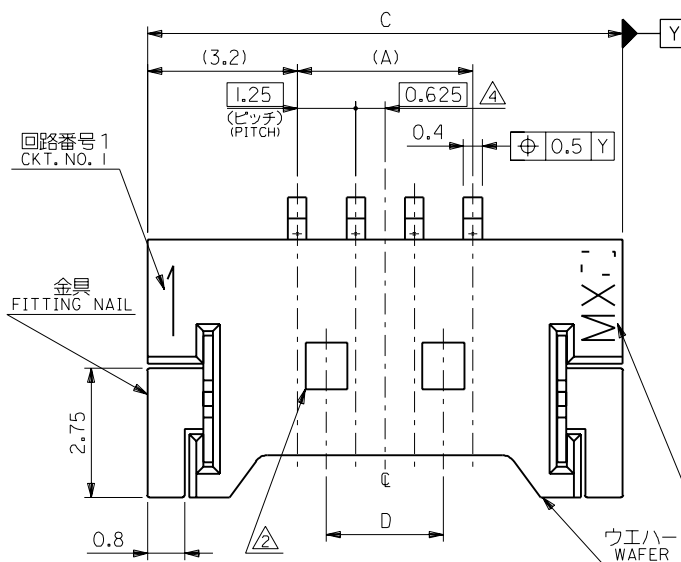
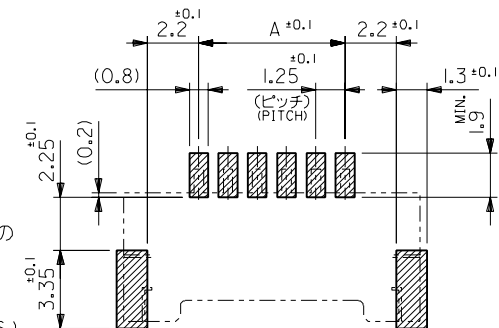
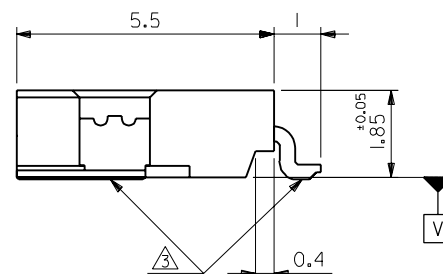
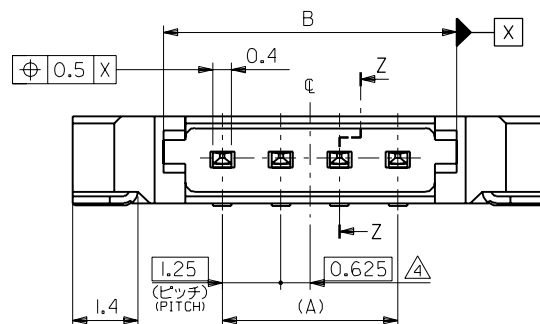




注記 NOTES

1. 嵌合相手: 51146 シリーズ
MATES WITH: 51146 SERIES
△ ロック窓は2、3極品は1箇所、4極品以上は2箇所とする。
LOCKING WINDOW: ONE PLACE FOR 2 AND 3 CIRCUIT PRODUCTS AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CIRCUIT PRODUCTS.
△ 基準面 [V] からのソルダーテールと金具の半田付け面のズレ量は、
上方に 0.05MAX. 下方に 0.15MAX. とし、20 極以下の相互のバラツキ量は 0.1MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL AND FITTING NAIL FROM [V]
: UPPER DIRECTION 0.05MAX.
: LOWER DIRECTION 0.15MAX.
: OFFSET BETWEEN UPPER AND LOWER 0.1MAX. (UNDER 20 CKTS.)
△ 偶数極の製品に適用。
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
5. 材質 MATERIAL
ウエハー WAFER: PPHS, UL94V-0
ピン: リン青銅 (コンタクト部: 金メッキ、テール部: 半田メッキ)
PIN: PHOS-BRO (CONTACT: Au PLATING, TAIL: Sn-Pb PLATING)
金具: リン青銅 (半田メッキ)
FITTING NAIL: PHOS-BRO (Sn-Pb PLATING)

トレードマーク
TRADE MARK参考基板レイアウト
RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN DIM. (REF.)

8.75	22.5	30.15	26.27	23.75	53780-2010	20
7.5	20	27.65	23.77	21.25	-1810	18
6.25	17.5	25.15	21.27	18.75	-1610	16
6.25	16.25	23.9	20.02	17.5	-1510	15
5	15	22.65	18.77	16.25	-1410	14
3.75	12.5	20.15	16.27	13.75	-1210	12
2.5	10	17.65	13.77	11.25	-1010	10
2.5	8.75	16.4	12.52	10	-0910	9
1.25	7.5	15.15	11.27	8.75	-0810	8
1.25	6.25	13.9	10.02	7.5	-0710	7
—	5	12.65	8.77	6.25	-0610	6
—	3.75	11.4	7.52	5	-0510	5
—	2.5	10.15	6.27	3.75	-0410	4
—	—	8.9	5.02	2.5	-0310	3
—	—	7.65	3.77	1.25	53780-0210	2
E	D	C	B	A	ENG. NO.	CKT. 極数

G	変更 REVISED	(JC2000-0862)	S.M.	'00/6/21
F	変更 REVISED	(JC80823)	S.M.	'98/4/22
E	変更 REVISED	(JC70644)	S.M.	'91/1/27
D	変更 REVISED	(JC70592)	S.M.	'91/1/3
C	変更 REVISED	(JC70159)	S.M.	'96/8/9
B	変更 REVISED	(JC60804)	S.M.	'96/5/1
A	変更 REVISED	(JC60541)	S.M.	'96/2/6
O	新規作成 PROPOSED	(JC60428)	Y.M.	'95/12/25
角 度	ANGLE	+3°		
30 以上	OVER	+0.3		
10 以上	OVER	+0.25		
10 未満	UNDER	+0.2		
角 度	ANGLE	+3°		
30 以上	OVER	+0.3		
10 以上	OVER	+0.25		
10 未満	UNDER	+0.2		
角 度	ANGLE	+3°		
30 以上	OVER	+0.3		
10 以上	OVER	+0.25		
10 未満	UNDER	+0.2		

角 度	ANGLE	+3°
30 以上	OVER	+0.3
10 以上	OVER	+0.25
10 未満	UNDER	+0.2
角 度	ANGLE	+3°
30 以上	OVER	+0.3
10 以上	OVER	+0.25
10 未満	UNDER	+0.2
角 度	ANGLE	+3°
30 以上	OVER	+0.3
10 以上	OVER	+0.25
10 未満	UNDER	+0.2

材 料	MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	—
被覆外径 INS. RANGE	—	—
DRAWN BY '95/12/25	CHK'D BY '00/6/21	
Y. MIZUNO	T. YAMAGUCHI	
APP'D BY '00/6/21	尺 度	—
M. FUKUSHIMA	SCALE	—

MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR S.M.T.
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-53780-***10
G

DWG. NO.
SD-53780-**-10

E

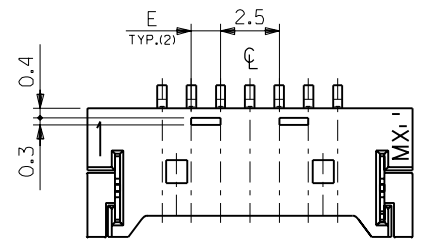
D

C

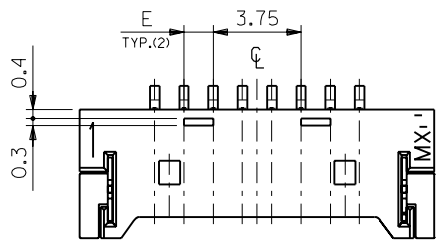
B

A

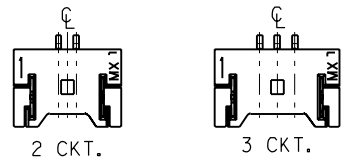
ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



7~19極の奇数極に適用
APPLY FOR ODD CIRCUITS OF 7~19



8~20極の偶数極に適用
APPLY FOR EVEN CIRCUITS OF 8~20



ロック形状図
LOCK CONFIGURATION

		G	変更 REVISED (JC2000-0862)	S.M.	T.Y.	'00/6/21	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
		F	変更 REVISED (JC80823)	S.M.	S.K.	'98/4/22			
		E	変更 REVISED (JC70644)	S.M.	Y.M.	'97/1/27	仕上げ FINISH	—#—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
		D	変更 REVISED (JC70592)	S.M.	Y.M.	'97/1/3			
角度 ANGLE	+3°	C	変更 REVISED (JC70159)	S.M.	Y.M.	'96/8/9	適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	TITLE 名称 1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR S.M.T.
30 以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED (JC60804)	S.M.	M.F.	'96/5/1	被覆外径 INS. RANGE	—#—	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (JC60541)	S.M.	H.H.	'96/2/6	DRAWN BY '95/12/25 Y.MIZUNO	CHK'D BY '00/6/21 T.YAMAGUCHI	
10 未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (JC60428)	Y.M.	H.H.	'95/12/25	APP'D BY '00/6/21 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —#—	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53780-**-10 G		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-53780-**-90

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

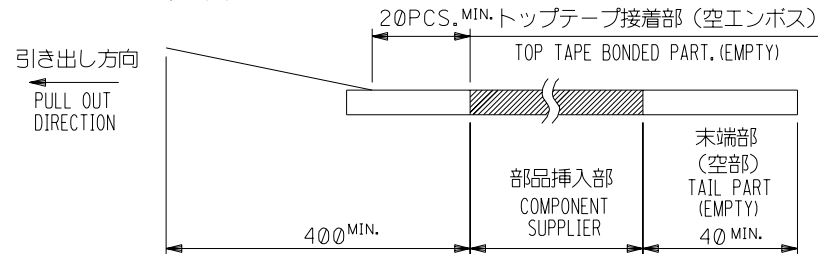
3

2

1

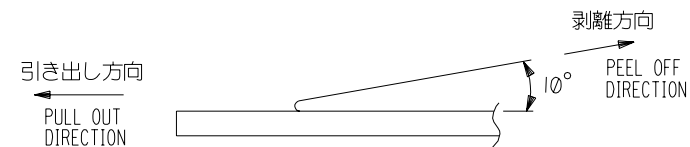
NOTES

- 梱包数量：1500個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1500PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



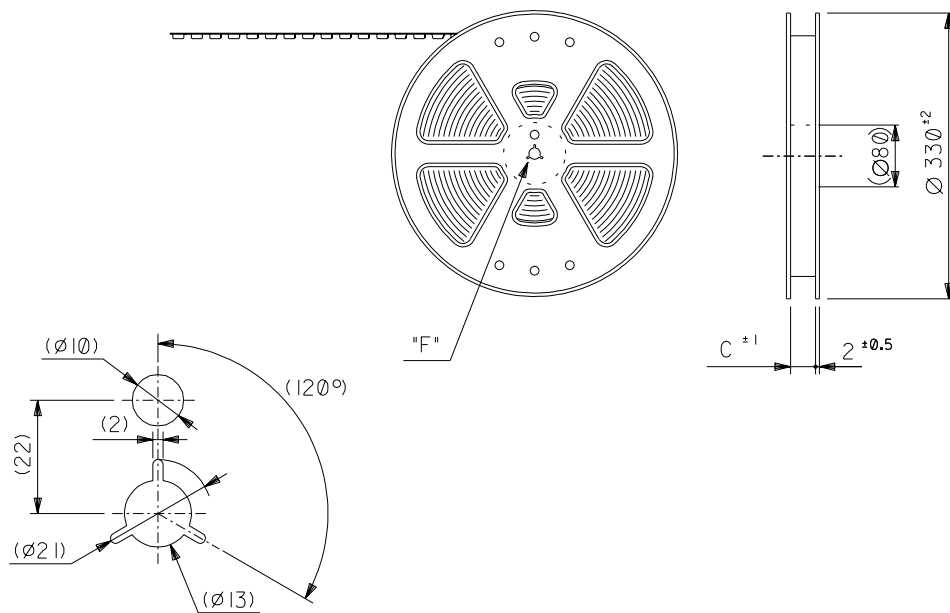
- トップテープの剥離強度：0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET , PE , PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



DETAIL "F"

		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTE	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
N	変更 REVISED (J2002-2940)	N.I.	'02/05/27	仕上げ FINISH	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
M	変更 REVISED (JC2001-0424)	K.K.	'00/12/6	適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称
L	変更 REVISED (JC2001-0318)	S.M.	'00/10/27	被覆外径 INS. RANGE	1.25 W/B WAFER ASS'Y EMBOSSSED TAPE PACKAGE
30 以上 OVER	+0.3	K	'98/12/1	DRAWN BY '95/12/27 S.MATSUZAKI	CHK'D BY '02/05/27 K.ASAKAWA
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	J	'98/3/11	DR. 日付 CHK. DATE	DWG. NO. (SHEET 1 OF 3)
10 未満 UNDER	+0.2	H	'98/2/20	REVISION RECORD	SD-53780-**-90
一般公差 GENERAL TOLERANCES		LTR			REV N

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

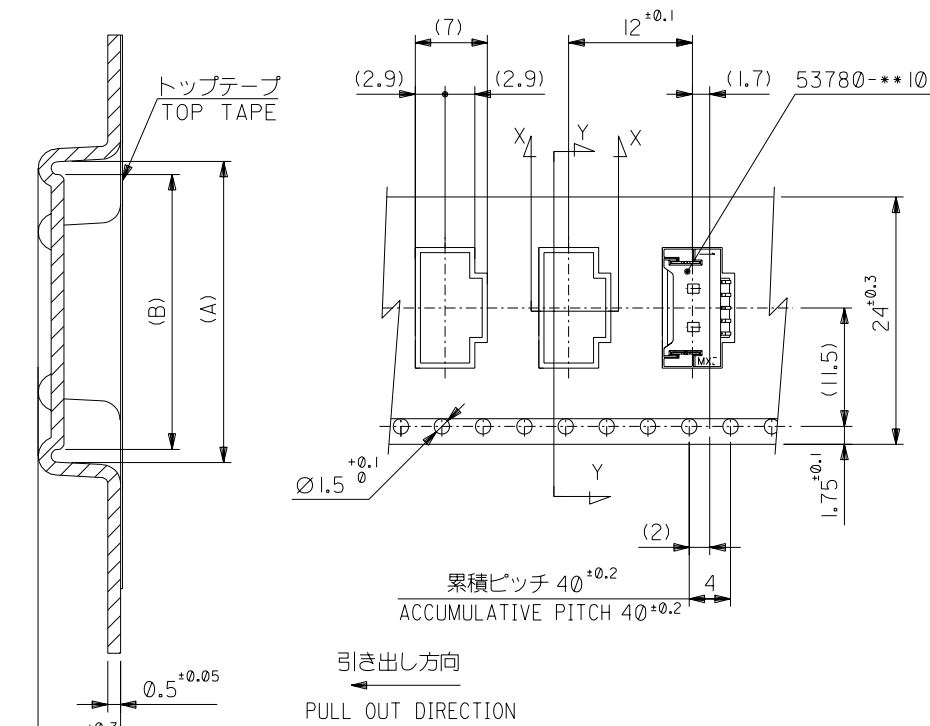
1

DWG. NO.
SD-53780-**-90

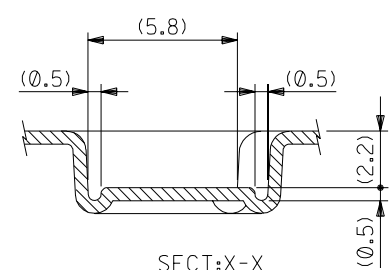
E

D

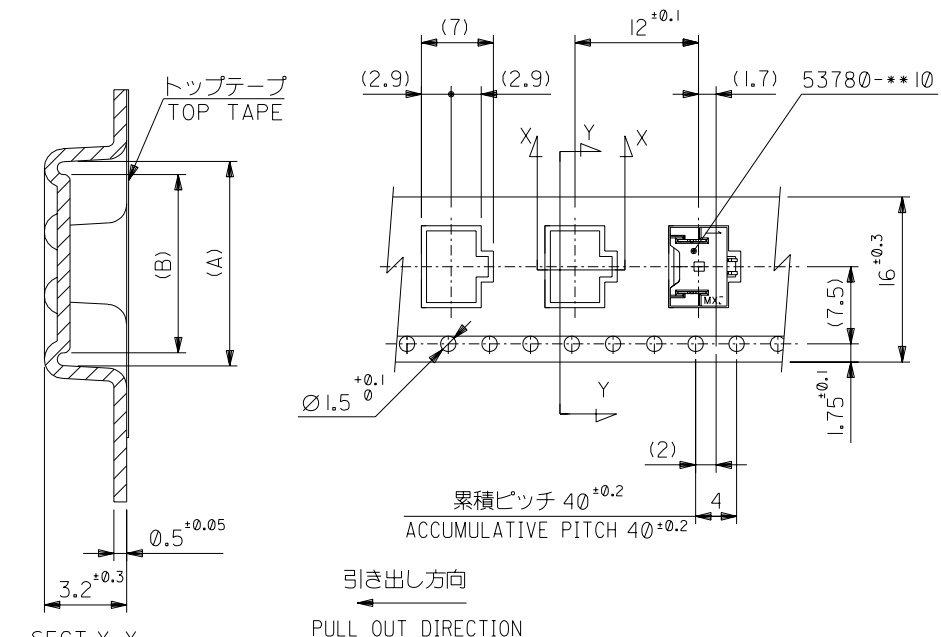
C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



SECT:Y-Y
(SCALE 5:1)



SECT:X-X
(SCALE 5:1)



SECT:Y-Y
(SCALE 5:1)

24	25.5	11.75	16.7	53780-0990	9
		10.5	15.45	53780-0890	8
		9.25	14.2	53780-0790	7
		8	12.95	53780-0690	6
		6.75	11.7	53780-0590	5
16	17.5	5.5	10.45	53780-0490	4
		4.25	9.2	53780-0390	3
		3	7.95	53780-0290	2
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	種数 CKT.

		材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
N 変更 REVISED (J2002-2940)		N.I K.A		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
M 変更 REVISED (JC2001-0424)		K.K T.V		TITLE 名称	
L 変更 REVISED (JC2001-0318)		S.M T.V		1.25 W/B WAFER ASS'Y EMBOSSD TAPE PACKAGE	
K 変更 REVISED (JC90327)		S.M T.V		DRAWN BY '95/12/27 S.MATSUZAKI	
J 変更 REVISED (JC80706)		T.A S.K		CHK'D BY '02/05/27 K.ASAKAWA	
H 再作図と変更 REDRAWN & REVISED (JC80662)		T.N S.K		DWG. NO. (SHEET 2 OF 3)	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		DR. CHK. 日付 DATE		SD-53780-**-90	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		REV N	

DWG. NO.
SD-53780-***90

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

8

7

6

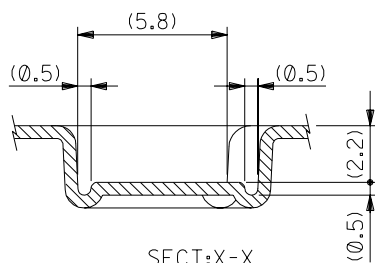
5

4

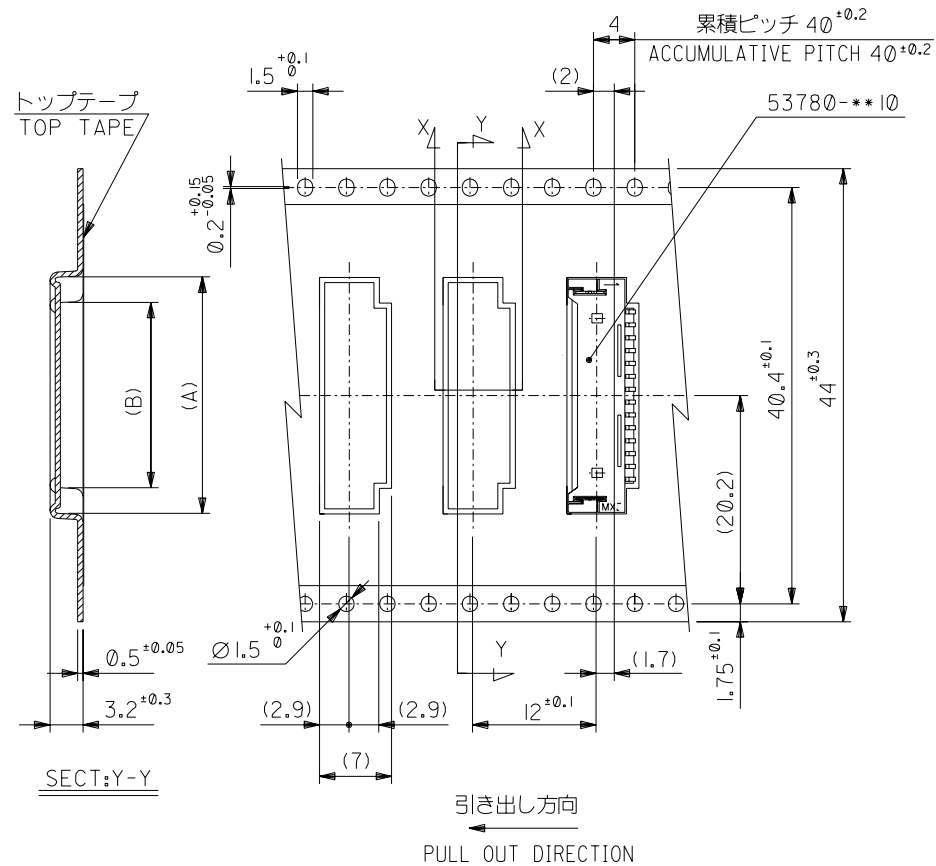
3

2

1



SECT:X-X
(SCALE 5:1)



44	45.5	28	32.95	53780-2290	22	
		25.5	30.45	53780-2090	20	
		25.5	27.95	53780-1890	18	
		19.25	24.2	53780-1590	15	
		18	22.95	53780-1490	14	
		15.5	20.45	53780-1290	12	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	ENG. NO.	種数 CKT.

				材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		1.25 W/B WAFER ASS'Y EMBOSSSED TAPE PACKAGE	
				DRAWN BY '95/12/27 S.MATSUZAKI		CHK'D BY '02/05/27 K.ASAKAWA	
				APP'D BY '02/05/27 T.YAMAGUCHI		尺度 SCALE	
				日付 DATE		DWG. NO. (SHEET 3 OF 3)	
				DR. CHK.		SD-53780-***90	
				記号 LTR		REV	
				変更内容 REVISION RECORD		N	
				角度 ANGLE			
				30° 以上 OVER			
				10° 以上 30° 未満 UNDER			
				10° 未満 UNDER			
				一般公差 GENERAL TOLERANCES			